



**Dk 3.4[※]
@2GHz**

**CTE z-axis
37ppm/°C**

Tg(DMA) 200°C

※樹脂量 70wt%

**用途
モバイル**
スマートフォン、タブレットPC など



Halogen-free

Laminate

R-A555W R-A555Y

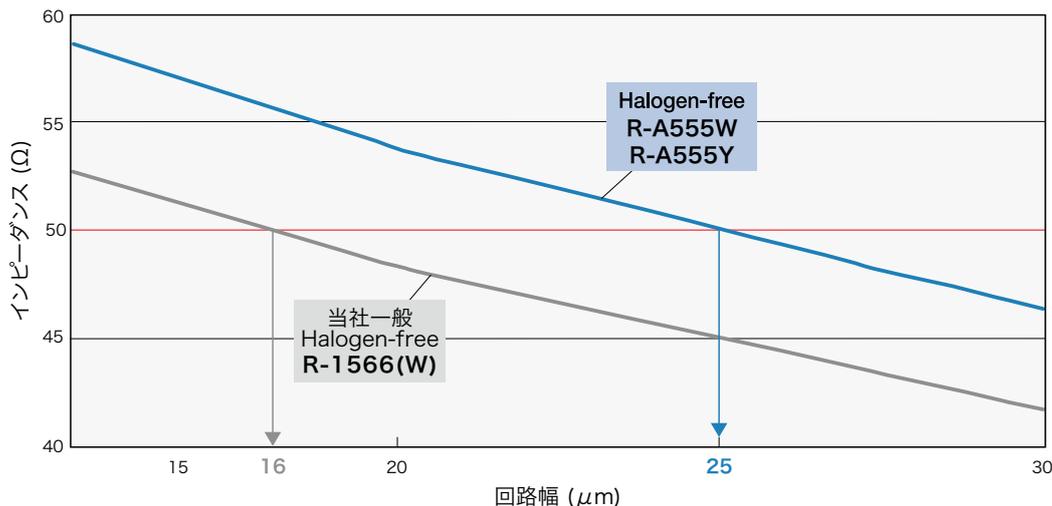
Prepreg

R-A550W R-A550Y

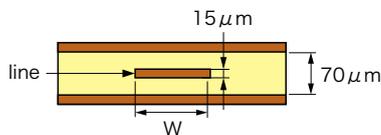
低誘電率ハロゲンフリー多層基板材料

極薄絶縁層のインピーダンス整合を容易にし、モバイル機器の更なる薄型化・小型化に貢献

インピーダンスシミュレーション(ストリップライン)



構成



一般特性

項目	試験方法	条件	単位	Halogen-free R-A555W R-A555Y	当社一般ハロゲンフリー R-1566(W)
ガラス転移温度(Tg)	DMA	A	°C	200	170
熱膨張係数(厚さ方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	α1	37
				α2	210
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	>60	3
比誘電率(Dk) ^{※1}	IPC-TM-650 2.5.5.5	C-24/23/50	-	2GHz	3.4
誘電正接(Df) ^{※1}				0.010	

試験片の厚さは0.8mmです。
※1 樹脂量 70wt%

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。
上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。